

Lotpaste NO-CLEAN TLF-204-171A, bleifrei, für Druckprozesse, 1 Kartusche = 600 g

Die bleifreie Lotpaste TLF-204-171AK ist entwickelt worden, um speziell die Anforderungen von anspruchsvollen Druckvorgängen zu erfüllen. Die Paste bietet exzellente Druckeigenschaften, sowohl cold slump als auch hot slump und damit auch die Bildung von unerwünschten Brücken werden vermieden. Durch die verbesserte Aktivierung des Flussmittels wird bei TLF-204-171AK eine Minimierung von Head-in-Pillow-Fehlern erreicht. Gleichzeitig führt die gute Aktivierung zu einer guten Benetzung auf den üblichen metallischen Oberflächen. Benetzungs- und Lotperlentest sowie die Konturenstabilität entsprechen höchsten Anforderungen. TLF-204-171AK ist eine NO-CLEAN Paste - die Rückstände können auf den Lötstellen verbleiben, ohne dass diese zu Problemen mit Korrosion oder Elektromigration führen.

- Lotpaste NO-CLEAN, bleifrei
- für Druckprozesse
- Klassifizierung ROLO
- Metallgehalt 88,5 %
- Legierung Sn96,5Ag3Cu0,5
- Korngröße 4 (20-38 µm)
- 1 Kartusche = 600 g
- Reduzierung von Head-in-Pillow-Fehlern
- Hohe Aktivität auf allen Substraten
- gute Benetzung auf den üblichen metallischen Oberflächen
- Exzellente Druckeigenschaften
- Gute Klebrigkeit von bis zu 24h
- Flussmittelklassifizierung J-STD-004: ROLO

[<https://www.tamura-elsold.de/index.php/de/downloads/sicherheitsdatenblaetter>] Laden Sie sich hier das passende Sicherheitsdatenblatt herunter]

Artikel-Nr.	WL45185
Modell	Pastentyp TLF-204-171AK
Hersteller	TAMURA ELSOLD
Hersteller-Artikel-Nr.	LOTPAST8004
Verkaufseinheit	1 Kartusche
Inhaltseinheit	600 g
Flussmittelklasse	ROLO
Bleifrei/Bleihaltig	bleifrei